

深圳天德钰科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币 25 亿元。
- 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2024 年 4 月 1 日，公司召开了第二届董事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事宜公告如下：

为提高企业资金营运能力，根据公司整体资金预算安排、经营战略及总体发展计划，公司拟向相关银行申请综合授信额度，授信总额为不超过等值人民币 25 亿元的人民币授信及外币授信。授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度和期限，以银行最终核定为准。

该授信有效期为自公司第二届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月。授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整，单笔融资可不再上报董事会或股东大会审议。授信申请工作中，金融机构如需要提供相关征信措施，公司将在履行相关审议批准程序后在上述额度内提供相应保证、质押、抵押或第三方担保。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

为提高工作效率，拟授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件，并同意授权管理层办理相关手续。授权有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2024年4月2日